



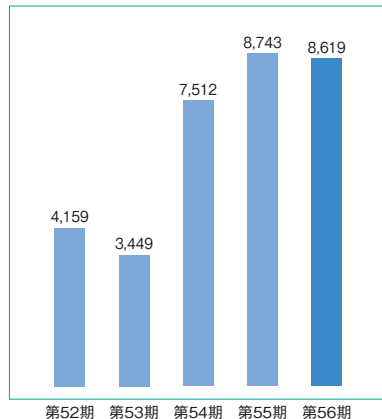
第 56 期 事業レポート

2023年4月1日～2024年3月31日

決算ハイライト(連結)

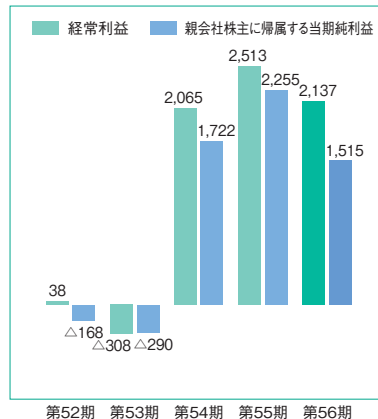
売上高

(単位：百万円)



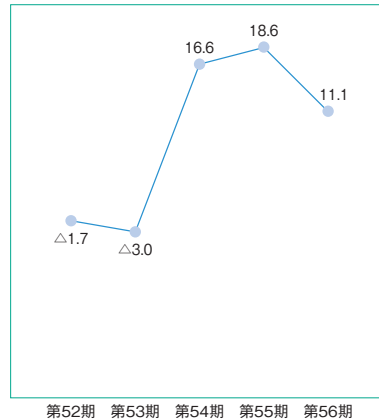
経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



自己資本利益率 (ROE)

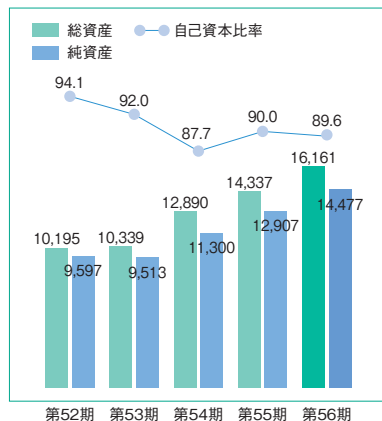
(単位：%)



総資産・純資産 自己資本比率

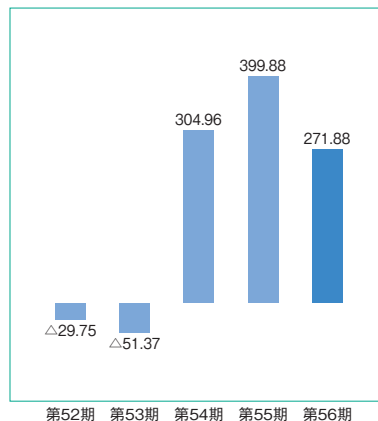
(単位：百万円)

(単位：%)



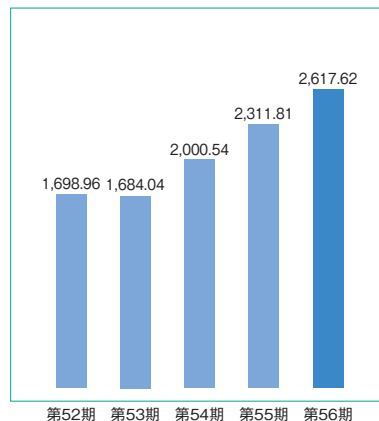
1株当たり当期純利益

(単位：円)



1株当たり純資産額

(単位：円)



トップメッセージ

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第56期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の事業の概況についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、米国では堅調な労働市場と消費活動を背景に景気は底堅く推移しましたが、欧州ではウクライナ危機や中東情勢の緊迫に伴う資源価格高騰によりインフレが拡大し、停滞が続きました。アジアでは、中国は政府債務の増加や不動産市場の低迷により成長が鈍化し、日本では円安進行や金融緩和からの脱却をめぐる議論が焦点となりました。

半導体業界におきましては、パソコンやスマートフォンの出荷台数が落ち込み、メモリを中心に生産調整が継続したことから、半導体製造装置市場は低迷しましたが、生成AIによる新たな需要が期待される他、米中の技術競争や貿易摩擦といった不確実性から戦略物資である半導体のサプライチェーンのあり方が各国で意識されており、半導体メーカーの中長期的な投資意欲は継続しました。

このような状況のなか、顧客ニーズに応える製品の開発・改良に注力するとともに、パワーデバイス用テストやMAPハンドラ、自重ハンドラを軸として、顧客基盤や取引規模の維持拡大に向けた販売活動を展開しました。生産面では、電子部品等の部材調達難が解消に向かうなか、一部ユニットの内製化や労働環境の整備など、供給体制の適正化に向けた取組みを推進しました。

以上の結果、受注高は68億92百万円（前期比19.7%減）、売上高は86億19百万円（同1.4%減）、期末受注残高は43億15百万円となりました。製品別売上高はハンドラ39億87百万円（同14.5%減）、テスト33億53百万円（同28.0%増）、パーツ等12億79百万円（同12.5%減）となりました。

損益面は、モデルミックスや部材高騰による影響から、営業利益は17億31百万円（同18.8%減）となりました。また、



代表取締役社長 田中 賢治

外貨建て資産に係る為替差益の計上により、経常利益は21億37百万円（同15.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は15億15百万円（同32.8%減）となりました。

データセンターの増強、自動車の電動化などのデジタル化、カーボンニュートラルへの取組みがトレンドとなるなか、半導体製造装置市場は短期的には変動しつつも、中長期的には堅調な推移が予想されます。

当社は、2022～2024年度を対象期間とする中期経営計画「Enjoy2.0」を策定の上、売上高100億円までストレッチできる体制の整備を進めてまいりましたが、テストは2023年度において中期目標である売上高30億円を達成した一方、2022年度第4四半期からハンドラの受注高が下降局面入りしております。事業環境の継続を前提とした中期計数目標（売上高100億円、営業利益25億円）は未達となる見込みですが、需要拡大を背景とした中長期的な成長に向け、基盤戦略、事業戦略、財務戦略に掲げる取組みを継続してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きより一層のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

車載関連を中心にパワーデバイス向け製品は堅調にスタート。 テストは中期売上目標を達成。ハンドラは市場の下落傾向を受けてスローに。

クラウドや生成AIがITの世界でホットな話題となる一方、パソコンやスマートフォンの低迷もあり、当期（2024年3月期）における半導体市場は、下落傾向にありました。そうしたなか、テセックが得意とするパワーデバイスの市況はどうだったのか、また、高騰する原材料価格への対応、前期に問題となった部品不足の状況、さらに今後の展望などについて、田中社長に伺いました。

Q 当期(2024年3月期)の事業環境および業績の概況をお聞かせください。

A 当期の世界経済は、米国経済が底堅く推移した一方、ウクライナ危機や中東情勢の緊迫に伴う資源価格高騰によりインフレが拡大、中国は不動産市場の低迷などにより経済は鈍化しました。日本においては、アフターコロナによってインバウンド需要が回復してきたものの、物価高が継続し一般消費にブレーキがかかりました。

半導体業界においては、パソコン、スマートフォンが低迷したこともあり、全体的には前年度からは落ち込む一方、生成AIによる新たな需要が期待される状況となりました。

そうしたなか、当社においては、中期経営計画「Enjoy2.0」に則り、基盤、事業、財務の各戦略を精力的に進めました。業績については、車載を中心にパワーデバイス用テストの需要が堅調に推移したものの、ハンドラの受注が回復に至らず、売上は伸び悩みました。また、円安による恩恵があった一方で、案件ミックスの悪化や部材価格の高騰が利益を圧迫したことから、当期の業績は前期比で減収減益となりました。

Q 部品不足と原材料価格の高騰の影響についてお聞かせください。

A まず、部品不足に関しては、前期までの2年間はかなり苦しめられました。現在も電源など特定のものが入手しづらい状況ですが、その点数はかなり絞られてきています。

また、前期は部品不足から通常の購入価格よりも何倍もの価格で購入せざるを得なかったものが多数ありました。当期は部品不足が解消傾向になったことから、一部を除いては本来の価格に近いところで入手できるようになってきています。原材料価格の高騰については、最大限、販売価格に転嫁しています。

Q 当期、注力したところについてお聞かせください。

A 開発においては、テストで2つの新製品を開発完了し、すでに第1号機を出荷しています。1つは、パワー半導体ウェハ用のDC（静特性）テストで、複数チップの同時測定を実現した新たなコンセプトモデルです。昨今の市場が求めるアバランシェ測定もワンパスで可能な点も大きな特長です。本機は国内の大手電機メーカー様に採用され、今後のニーズも大きく期待されます。

もう1つは、当社が長年培ってきたパワーディスクリート半導体の測定技術をベースに、ICテストの技術を採用入れたテストシステムで、ターゲット市場拡大を企図した戦略モデルです。

ハンドラについては、新製品はないものの、全体的にブラッシュアップを進め、環境試験も広くラインナップしています。

また、当期から開始したものではありませんが、ここ数年、生産サポートに注力しています。生産サポートには様々な領域がありますが、保全やトラブルに対するサポートサービスが中心です。以前は技術者や製造担当が直接お客様のところに出向いてサポートしていました。しかし現在は、独自のトレーニングメニューを作成して、現地法人や代理店でも対処できるよう体制強化を図っています。トレーニングメニューを終了すれば修了証が交付されるので、モチベーションの向上にもなっているようです。

もっとも、現地では解決できない事案も発生します。そうしたケースでは、スマートグラスなどを活用して現場の状況を映像で送ってもらい、本社で対応します。コロナ禍という特殊事情によって現地対応、リモート対応を余儀なくされたわけですが、こうした対応にも理解が広がったと思っています。結果的に、よりタイムリーに対応できるだけでなく、従業員の負担軽減、出張コスト削減にもつながっています。

Q 中期経営計画の進捗と今期(2025年3月期)の展望をお聞かせください。

A データセンターの増強、端末の高性能化が進み、自動車においてもデジタル化やEVシフトなどのカーボンニュートラルへの取組みが継続されていくと予想されます。そのうえで、半導体製造装置の市場は、短期的には変動しつつも、中長期的には成長が見込まれます。

3ヵ年計画「Enjoy2.0」は今期、最終年度に当たりますが、基盤戦略および財務戦略については着実に進展しています。

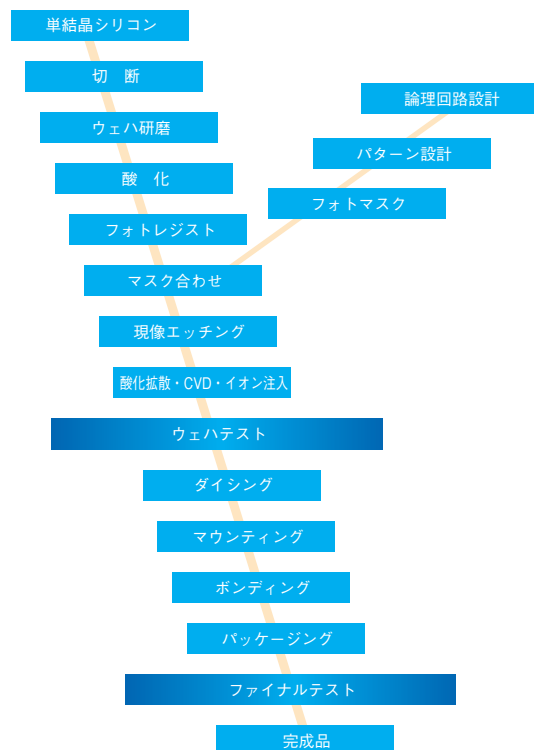
事業戦略においては、テストは事業基盤の強化が進み、計数としても目標値を達成することができましたが、ハンドラは2023年3月期の第4四半期から受注低迷が続いています。今期の業績は「Enjoy2.0」の中期計数目標を下回る見込みですが、中長期的な成長に向けた取組みを継続してまいります。

Q 最後に、株主様へのメッセージをお願いします。

A 利益創出の基盤強化は確実に進んでいるという実感はあるものの、まだまだポテンシャルを高めていかなければなりません。そのためには研究・開発の深化はもちろん、グローバル規模での営業基盤の拡大・強化に努める必要があると考えています。

中期計画において総還元性向35%を掲げておりますが、今後も企業価値向上に向けた成長投資と株主還元の両立を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

半導体検査装置の、 リーディングカンパニーとして、グローバルに、 そして独創的にカスタマーニーズにお応えしています。



製造された各種半導体の品質による分類・選別処理を自動的に行うハンドラ、ハンドラと連動して半導体の電気特性を高速・高精度で測定し、分類・選別の基準となるデータを提供するテスト。これら半導体検査装置は半導体の最終検査（ファイナルテスト）を担い、その精度は半導体、さらには電子機器などの最終製品の品質を決定するといっても過言ではありません。

また、近年は当社の強みである高電圧・大電流なパワー半導体（※）測定技術を継承しつつ、長年蓄積してきた測定技術を活用し、ウェハテスト工程に対応した新しいタイプのテストにも注力しております。複数チップを同時測定処理することにより、従来テストに比べ大幅に生産性向上を図ることができます。

テセックは、ハンドラとテストの専門メーカーとして、また、それらを組合わせたテストシステムのトータルサプライヤーとして、長年のノウハウと確かな技術力を駆使して、高品質・高信頼を追求してきました。

さらに今、トータルシステムや特化したカスタマーニーズへの対応など、検査装置の領域を超えたソリューションの提供にも積極的に挑戦しています。

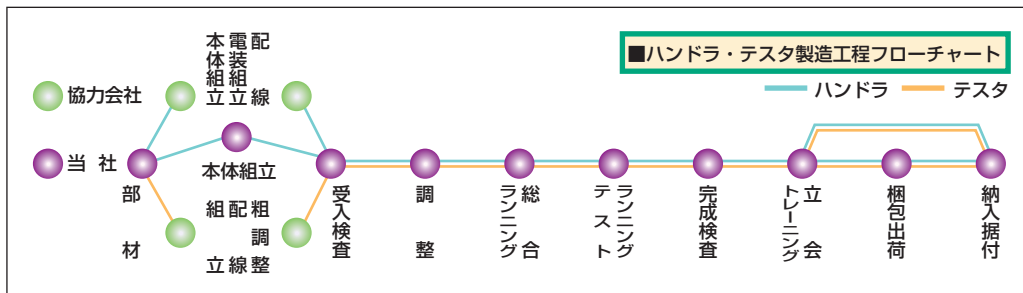
パワー半導体とは = 電力制御や供給機能がある半導体

例えば自動車では、
従来の内燃機関はガソリンなど燃料を使用 ⇒ 排気ガスを排出
パワー半導体は燃料を使わず、電気を使用
電気（電圧や電流）により動力を発生し制御 ⇒ 排気ガスゼロ



パワー半導体による地球温暖化抑制とCO₂削減が可能

この**パワー半導体**の信頼性試験に**当社製品**が貢献！



半導体業界は刻々と変わりゆく技術やデバイスの多様化によって、当社が手がける検査装置に求められるレベルも高度になりつつあります。このような時代の流れに対応するために、これまで独自技術のオリジナリティを磨き、他社との差別化を図ってきました。すでに定評のあるハンドラとテストはもちろん、MEMSハンドラや一貫システムまで、最先端の市場を見据えた幅広いラインナップでカスタマーニーズにお応えしています。

ハンドラ

ハンドラとは、接続されたテストからの測定データを受け、設定されたレベルに応じて各種半導体デバイスを自動的に分類・選別する装置です。

チェンギットによりデバイスの形状、サイズ、重さなどの変化にも柔軟に対応でき、同時にコンパクト設計、シンプル機構、優れた操作性、低価格を実現しています。

対象半導体の種類、用途によっては温度試験対応などの機能が付加され、さらに半導体製造の後工程となるリード切断やマーキングを同時に行う一貫システムも充実しています。

テスト

テストとは、各種半導体デバイスの電気特性を高速・高精度に測定するテストシステムです。パソコンの搭載で、ウィンドウズの画面上で対話型式によるテストプログラムを簡単に作成でき、ネットワークにも接続できます。

特に大電流、高電圧に対応するテストシステムでは高度な計測技術により他社の追随を許さない性能を誇り、長年にわたって高シェアを維持しています。また、ロジックICを対象としたDC測定、時間測定、ファンクション測定などの分野もカバーしています。



MEMSテストハンドラ



パワーデバイス用パラレルテストシステム

半導体製造工場が稼働する世界全地域をカバー。 このネットワークが、信頼をより強固に。

リアルタイムの情報を世界各地から収集・分析し、製品や提案として発信するテセックのビジネスモデル。設立当時に、半導体先進国だったアメリカ系企業から技術力を認められ、いち早くグローバルに展開できたことが、独自性を際立たせるきっかけとなりました。以来今日まで拓かれた販売・サービス網は、半導体製造工場のある世界全域をカバーし、なかでもアメリカ、マレーシア、中国の現地法人では、現地のお客様に向けてきわめて密接な営業活動・情報収集を実践しています。そこから生まれる新たな製品・ソリューションは、海外代理店も巻き込んでまさにグローバルに波及し、世界各地での半導体ビジネスに貢献しています。



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 2023年3月31日現在	当連結会計年度 2024年3月31日現在
(資 産 の 部)		
流 動 資 産	9,903	11,208
現金及び預金	3,136	3,858
受取手形	2	7
電子記録債権	20	438
売掛金	1,891	1,974
有価証券	725	832
製 品	296	202
仕掛品	2,602	2,693
原材料	702	822
未収消費税等	380	256
その他	147	124
貸倒引当金	△ 1	△ 2
固 定 資 産	4,433	4,952
有形固定資産	1,488	1,506
建物及び構築物	2,505	2,506
減価償却累計額	△ 2,207	△ 2,225
建物及び構築物(純額)	297	280
機械装置及び運搬具	114	122
減価償却累計額	△ 105	△ 109
機械装置及び運搬具(純額)	9	12
工具、器具及び備品	709	724
減価償却累計額	△ 662	△ 646
工具、器具及び備品(純額)	47	77
土 地	1,134	1,134
無形固定資産	86	430
ソフトウェア	18	15
ソフトウェア仮勘定	66	179
技術関連資産	-	234
その他	1	1
投資その他の資産	2,859	3,016
投資有価証券	2,474	2,618
退職給付に係る資産	69	173
繰延税金資産	102	2
保険積立金	191	207
その他	25	19
貸倒引当金	△ 4	△ 4
資 産 合 計	14,337	16,161

科 目	前連結会計年度 2023年3月31日現在	当連結会計年度 2024年3月31日現在
(負 債 の 部)		
流 動 負 債	1,391	1,368
買掛金	387	151
未払金	117	215
未払費用	126	140
契約負債	252	208
未払法人税等	179	320
賞与引当金	196	194
製品保証引当金	37	79
修繕引当金	59	0
その他	35	58
固 定 負 債	37	315
長期未払金	1	1
繰延税金負債	27	309
その他	8	4
負 債 合 計	1,429	1,683
(純 資 産 の 部)		
株 主 資 本	12,465	13,301
資 本 金	2,521	2,521
資 本 剰 余 金	3,376	3,381
利 益 剰 余 金	6,982	7,939
自 己 株 式	△ 414	△ 540
その他の包括利益累計額	441	1,175
その他有価証券評価差額金	472	1,104
為替換算調整勘定	△ 31	70
非支配株主持分	1	1
純 資 産 合 計	12,907	14,477
負 債 純 資 産 合 計	14,337	16,161

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2022年4月1日 至：2023年3月31日	自：2023年4月1日 至：2024年3月31日
売 上 高	8,743	8,619
売 上 原 価	4,652	4,794
売 上 総 利 益	4,090	3,825
販売費及び一般管理費合計	1,957	2,094
営 業 利 益	2,133	1,731
営 業 外 収 益 合 計	394	421
営 業 外 費 用 合 計	14	14
経 常 利 益	2,513	2,137
特 別 利 益 合 計	－	3
特 別 損 失 合 計	56	－
税金等調整前当期純利益	2,456	2,141
法人税、住民税及び事業税	435	474
法 人 税 等 調 整 額	△ 234	151
法 人 税 等 合 計	201	625
当 期 純 利 益	2,255	1,515
非支配株主に帰属する当期純利益	0	0
親会社株主に帰属する当期純利益	2,255	1,515

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2022年4月1日 至：2023年3月31日	自：2023年4月1日 至：2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,445	871
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117	149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 676	△ 691
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	224
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	814	554
現金及び現金同等物の期首残高	2,233	3,048
現金及び現金同等物の期末残高	3,048	3,602

連結対象子会社

アメリカ	TESEC, INC. /Head Office (カリフォルニア州) /Arizona Office (アリゾナ州)
マレーシア	TESEC (M) SDN.BHD.
中国	泰賽国際貿易 (上海) 有限公司

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	2,521	3,376	6,982	△ 414	12,465	472	△ 31	441	1	12,907
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当			△ 558		△ 558					△ 558
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			1,515		1,515					1,515
自 己 株 式 の 取 得				△ 140	△ 140					△ 140
自 己 株 式 の 処 分		4		13	18					18
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)						632	102	734	0	734
当 期 変 動 額 合 計	－	4	956	△ 126	835	632	102	734	0	1,569
当 期 末 残 高	2,521	3,381	7,939	△ 540	13,301	1,104	70	1,175	1	14,477

会社概要

社名	株式会社テセック TESEC Corporation
所在地	本社（〒207-0023） 東京都東大和市上北台三丁目391番地の1 TEL：042-566-1111（代） FAX：042-562-6161 伊那事業所（〒399-4601） 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346 TEL：0265-79-6611（代） FAX：0265-79-7883 テセック熊本（〒861-2202） 熊本県上益城郡益城町田原1155-12 テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F TEL：096-287-1551 FAX：096-287-1552
設立	1969年12月22日
資本金	25億21百万円
従業員数	212名（連結）、184名（単体）（2024年3月31日現在）
海外現地法人	TESEC, INC.（アメリカ） TESEC（M）SDN. BHD.（マレーシア） 泰賽国際貿易（上海）有限公司（中国）
事業内容	半導体検査装置であるハンドラ（半導体の電氣的測定結果をもとに性能毎に分類・選別する装置）、 テスト（半導体の性能を電氣的に測定する装置） およびパーツ等（予備部品、保守部品等）の開発・ 製造・販売
URL	https://www.tesec.co.jp

役員（2024年6月27日現在）

代表取締役社長	田中賢治
取締役	宮脇浩幸
取締役	渡邊弘一
取締役	戸田雄介
取締役（常勤監査等委員）	尾亦利夫
取締役（監査等委員）	南川忠良
取締役（監査等委員）	舩川博昭

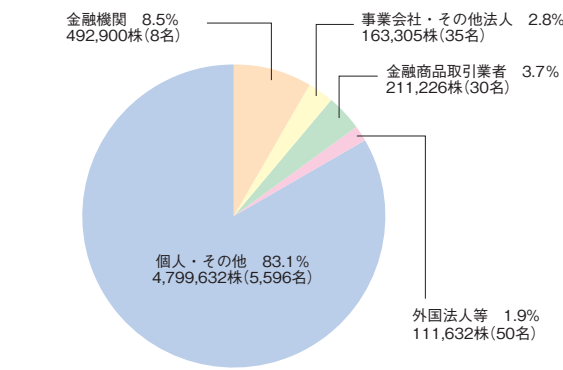
株式状況（2024年3月31日現在）

発行可能株式総数	20,000,000株
発行済株式の総数	5,778,695株
株主数	5,719名
大株主（上位10名）	

株主名	持株数	持株比率
田中 綏子	376千株	6.8%
村井 昭	276	5.0
日本生命保険相互会社	186	3.4
勝田 知男	177	3.2
山村 博	166	3.0
株式会社りそな銀行	164	3.0
テセック社員持株会	117	2.1
大塚 佳苗	106	1.9
大塚 正樹	103	1.9
大塚 裕三	95	1.7

(注) 1.当社は、自己株式を248,342株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



株 主 メ モ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基準日 3月31日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公告方法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載いたし
ます。
URL <https://www.tesec.co.jp>
1単元の株式数 100株

株式会社 テセック

本社 〒207-0023 東京都東和上市北台三丁目391番地の1
TEL 042-566-1111（代） FAX 042-562-6161
伊那事業所 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346
TEL 0265-79-6611（代） FAX 0265-79-7883
テセック熊本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原1155-12
テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F
TEL 096-287-1551 FAX 096-287-1552

URL <https://www.tesec.co.jp>